2012 年 5 月 7 日

プレスリリース

DMP が SMAPH®-S シリーズにマルチコア構成およびコンピューティングに対応した新しい OpenGL ES 2.0 ハイエンド IP コアを発表

ローエンドコアのバリエーションを拡張する世界最小の OpenGL ES 2.0 対応 IP コア SMAPH-S Lite、OpenGL ES 2.0 対応 2D/3D ハイブリッド IP コア SMAPH-H2 の提供も開始

株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル(本社: 東京都武蔵野市、東証マザーズ: 証券コード 3652、代表取締役 C.E.O. 山本達夫、以下 DMP)は、プログラマブルシェーダ機能を搭載した最先端の 2D/3D グラフィックス IP コア SMAPH-S シリーズの大幅な拡充および OpenGL ES 2.0 に対応した SMAPH-H2 を発表しました。

- 業界最高レベルのグラフィックスレンダリングとコンピューティングを実現する、マルチコア構成に対応した OpenGL ES 2.0 対応ハイエンド IP コア
- 世界最小サイズ OpenGL ES 2.0 対応 IP コア、SMAPH-S Lite
- OpenGL ES 1.1 及び OpenVG 1.1 API への準拠に加え、新たに OpenGL ES 2.0 API にも対応した SMAPH-H2

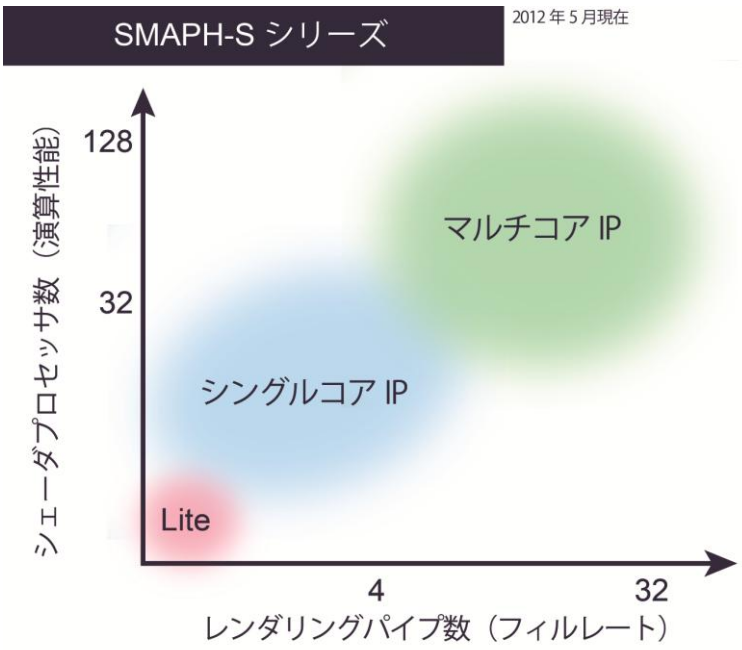
SMAPH-S シリーズおよび SMAPH-H2 のコアは直ちに顧客に提供可能です。

DMP の SMAPH-S シリーズは OpenGL ES 2.0 に対応しており、業界で最も幅広い拡張性を誇るグラフィックス IP コアを取りそろえています。SMAPH-S Lite は世界最小の OpenGL ES 2.0 対応 IP コアです。SMAPH-S のハイエンド構成は業界最高レベルのパフォーマンスと業界他社製品に比べ 2-4 倍の省コア・省電力を実現します。最先端アーキテクチャにより設計されたこの新製品は、最大 4 マルチコアまでサポートし、コアごとに最大 32 個のシェーダプロセッサと最大 4 本のレンダリングパイプラインを実装可能です。これによりシリーズとして最大 128 個のシェーダプロセッサと最大 16 本のレンダリングパイプラインを搭載することができ、タブレットやハイエンドスマートフォンを含む幅広いターゲットプラットフォームに要求される性能、シリコンサイズ及び消費電力に柔軟に対応します。

世界最小 3D グラフィックス IP コア SMAPH-S Lite は革新的な省電力技術と OpenGL ES 2.0 ベースのシェーダパイプラインの最適化により、業界最高レベルの低消費電力を実現します。SMAPH-S Lite は、低消費電力、性能、低コストを兼ね備える GPU ソリューションとして、低コストスマートフォンをはじめ、プリンタやデジタルカメラのような幅広いコンシューマデバイス向けに最適化されています。

新しいハイブリッドグラフィックス IP コア SMAPH-H2 は、OpenGL ES 1.1 及び OpenVG 1.1 API への準拠に加え、新たに OpenGL ES 2.0 API にも対応します。
高性能・高品質ユーザーインターフェース向けに最適化されたグラフィックス IP コアである SMAPH-H2 は、OpenGL ES 2.0 に対応するに当たり、性能を低下させずにハードウェアコンポーネントをシェアする独自ハイブリットアーキテクチャにより回路サイズと消費電力の削減を達成しました。SMAPH-H2 はベクターグラフィックスを必要とするモバイルコンシューマーデバイスへのソリューションとして最先端のグラフィックス IP コアとなります。

DMP 代表取締役 C.E.O. 山本達夫のコメント
「私たちの顧客は低コスト、省電力でありながら優れた性能と快適なユーザーインターフェースを実現できるグラフィックス・ソリューションを求めています。また、今後ますます高解像度化されるスマートフォンやタブレットデバイスに要求される描画性能を達成するには、性能をスケーラブルに増加させることができるマルチコア対応のグラフィックス IP コアが必要です。単位面積当たり最高の性能と省電力を実現する SMAPH-S シリーズおよび SMAPH-H2 は、ローエンドからハイエンドまで最適なコアの構成をサポートすることにより、顧客の要求を満たす最高のソリューションを提供します。これにより DMP は業界のリーダーシップをさらに強化できると考えています」



DMP は新しい SMAPH-S グラフィックスコアシリーズおよび SMAPH-H2 を、日本最大の組込み技術展示会である、「第 15 回 組込みシステム開発技術展（ESEC 2012）」とアジア最大のコンピュータ展示会である「COMPUTEX TAIPEI 2012」で展示します。

〔第 15 回 組込みシステム開発技術展（ESEC 2012） 概要〕
会期 ： 2012 年 5 月 9（水）～11 日（金）
時間 ： 10:00～18:00 （最終日は 17:00 まで）
会場 ： 東京ビッグサイト 西 2 ホール
ホームページ ： http://www.esec.jp/
DMP 出展位置:ブース番号「西 11-15」

〔COMPUTEX TAIPEI 2012 概要〕
会期 ： 2012 年 6 月 5（火）～9 日（土）
時間 ： 9:30～18:00 （最終日は 16:00 まで）
会場 ： 台北世界貿易センター第 1 ホール（TWTC Exhibition Hall 1）
ホームページ ： http://www.computextaipei.com.tw/
DMP 出展位置:COMPUTREND エリア ブース番号「C0323」

###

株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)について
2002 年7月の会社設立以来、DMP(東証マザーズ: 証券コード 3652)は日本発のリーディング・テクノロジー・カンパニーとして、主に組込み市場向けに最適な 3D グラフィックス技術の開発を続けています。幅広い組込み製品をカバーするハード、ソフトを含む 3D グラフィックス・ソリューションにより、新しいユーザー体験を提供する事を目指しています。また Khronos グループのメンバーとして OpenGL ES の仕様策定に主導的役割を果たすほか、日本で唯一の OpenGL ES プログラミング・トレーニングを実施しています。

©2012 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル
DMP、DMP ロゴ、および SMAPH は株式会社ディジタルメディアプロフェッショナルの登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

本件に関するお問い合わせ先
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 広報担当:桐井／IR 担当:伊藤
TEL:0422-60-3480 e-mail:info_06@dmprof.com
Web サイト: http://www.dmprof.com/company/inquiry_form/